

中国芯片制造商行业市场发展分析及发展趋势与投资前景研究报告(2026-2031版)

报告简介

广义芯片包括了集成电路、传感器、分立器件、光电器件产品，狭义芯片单指集成电路。晶圆制造主要为晶圆制造代工厂。全球主要晶圆代工企业有台积电(TSMC)、格罗方德(Global Foundries)、联电(UMC)、中芯国际(SMIC)、高塔半导体(Tower jazz)、力晶(Power Chip)、世界先进(VIS)、华虹、东部高科(Dongbu HiTek)、X-Fab、SSMC。其中，中芯国际、华虹为中国大陆企业。大陆的企业还有三安光电、士兰微、华力微电子、长鑫存储、普华存储、长江存储。

2020年，我国集成电路产业整体规模达到8848亿元，同比增长17%， “十三五” 期间年均复合增长率为19.6%。我国集成电路产业结构也实现突破性改善，2020年集成电路制造业规模实现对封测业规模的历史首次超越。

我国集成电路产业结构在持续优化。2020年我国芯片设计业规模达到3778.4亿元，同比增长高达23.3%； “十三五” 期间，芯片设计业规模年均复合增长率达23.3%。2020年我国芯片制造业规模达到2560.1亿元，同比增长19.1%， “十三五” 期间的年均复合增长率达23.2%。2020年我国封测业规模2509.5亿元，同比增长6.8%， “十三五” 期间的年均复合增长率为12.6%。

汽车、手机、服务器、个人电脑、基站、家电是芯片几大较为重要的下游应用领域。我们认为随着智能汽车、人工智能、物联网等技术的发展，汽车、5G手机等领域有望成为驱动半导体行业进一步增长的重要动力。鉴于芯片需求如此旺盛，现在的预期是芯片短缺局面将在 2022年年中至年底结束，具体取决于芯片类型。如果2022年情况还未能好转，那么缺芯的局面可能将持续到2023 年。

本研究咨询报告由北京中道泰和信息咨询有限公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、51行业报告网、

全国及海外多种相关报纸杂志的基础信息等公布和提供的大量资料和数据，客观、多角度地对中国芯片制造行业市场进行了分析研究。报告在总结中国芯片制造行业行业发展历程的基础上，结合新时期的各方面因素，对中国芯片制造行业行业的发展趋势给予了细致和审慎的预测论证。报告资料详实，图表丰富，既有深入的分析，又有直观的比较，为芯片制造行业的企业在激烈的市场竞争中洞察先机，能准确及时的针对自身环境调整经营策略。

报告目录

第一章 芯片制造商市场特征

第一节 行业简介

一、行业概述

二、行业特征

1、行业消费特征

2、行业产品结构特征

第二节 经济环境分析

一、经济发展状况

二、收入增长情况

三、固定资产投资

四、存贷款利率变化

五、人民币汇率变化

第三节 政策环境分析

一、国家宏观调控政策分析

二、芯片制造商行业相关政策分析

第四节 芯片制造商行业发展的"波特五力模型"分析

- 一、行业内竞争
- 二、买方侃价能力
- 三、卖方侃价能力
- 四、进入威胁
- 五、替代威胁

第二章 中国芯片制造商行业产业链(上、下游及关联产业)状况分析

第一节 上游产业发展状况分析

第二节 下游产业发展状况分析

第三节 关联产业发展状况分析

第三章 中国芯片制造商市场规模分析

第一节 中国芯片制造商市场规模分析

第二节 中国芯片制造商区域结构分析

第三节 中国芯片制造商区域市场规模分析

- 一、东北地区市场规模分析
- 二、华北地区市场规模分析
- 三、华东地区市场规模分析
- 四、华中地区市场规模分析
- 五、华南地区市场规模分析
- 六、西部地区市场规模分析

第四章 中国芯片制造商国内市场综述

第一节 中国芯片制造商产业产量分析及预测

- 一、芯片制造商产业总体产能规模

二、芯片制造商生产区域分布

三、总产量

四、消费情况

第二节 中国芯片制造商价格趋势分析

一、中国芯片制造商当前市场价格及分析

二、影响芯片制造商价格因素分析

三、2026-2031年中国芯片制造商价格走势预测

第五章 中国芯片制造商行业进出口市场情况分析

第一节 中国芯片制造商行业进出口量分析

一、中国芯片制造商行业进口分析

二、中国芯片制造商行业出口分析

第二节 2026-2031年中国芯片制造商行业进出口市场预测分析

一、2026-2031年中国芯片制造商行业进口预测

二、2026-2031年中国芯片制造商行业出口预测

第三节 影响进出口变化的主要原因分析

第六章 中国芯片制造商行业市场供需状况分析

第一节 2021-2026年中国芯片制造商行业市场状况分析

第二节 中国芯片制造商行业市场需求分析及预测

一、2021-2026年芯片制造商行业市场需求状况分析

二、2026-2031年芯片制造商行业市场需求预测分析

第三节 中国芯片制造商行业市场供给情况分析

一、2021-2026年芯片制造商行业市场供给状况分析

二、2026-2031年芯片制造商行业市场供给预测分析

第四节 2026-2031年中国芯片制造商供需平衡预测

第七章 全国芯片制造商行业财务状况分析

第一节 2021-2026年芯片制造商行业规模分析

一、芯片制造商行业总资产对比分析

二、芯片制造商行业企业单位数对比分析

三、芯片制造商行业从业人员平均人数对比分析

第二节 芯片制造商行业经济效益分析

一、芯片制造商行业资金利润率对比分析

二、芯片制造商行业成本费用利润率对比分析

第三节 芯片制造商行业效率分析

一、芯片制造商行业资产负债率对比分析

二、芯片制造商行业流动比率对比分析

第四节 芯片制造商行业结构分析

一、芯片制造商行业地区结构分析

二、芯片制造商行业所有制结构分析

三、芯片制造商行业不同规模企业结构分析

第五节 芯片制造商行业不同规模企业财务状况分析

一、芯片制造商行业不同规模企业盈利能力分析

二、芯片制造商行业不同规模企业营运能力分析

三、芯片制造商行业不同规模企业偿债能力分析

第八章 国内外芯片制造商重点企业分析

第一节 三安光电股份有限公司

一、公司概况

- 1、主营业务
- 2、行业地位
- 3、公司核心竞争优势

二、企业财务数据分析

- 1、企业资产负债分析
- 2、企业收入及利润分析

三、发展战略

- 1、经营模式
- 2、发展战略

第二节 中芯国际集成电路制造有限公司

一、公司概况

- 1、主营业务
- 2、行业地位
- 3、公司核心竞争优势

二、企业财务数据分析

- 1、企业资产负债分析
- 2、企业收入及利润分析

三、发展战略

- 1、经营模式
- 2、发展战略

第三节 台湾积体电路制造股份有限公司

一、公司概况

- 1、主营业务
- 2、行业地位
- 3、公司核心竞争优势

二、企业财务数据分析

- 1、企业资产负债分析
- 2、企业收入及利润分析

三、发展战略

- 1、经营模式
- 2、发展战略

第四节 杭州士兰微电子股份有限公司

一、公司概况

- 1、主营业务
- 2、行业地位
- 3、公司核心竞争优势

二、企业财务数据分析

- 1、企业资产负债分析
- 2、企业收入及利润分析

三、发展战略

第五节 上海华虹(集团)有限公司

一、公司概况

1、主营业务

2、行业地位

3、公司核心竞争优势

二、企业财务数据分析

1、企业资产负债分析

2、企业收入及利润分析

三、发展战略

1、经营模式

2、发展战略

第九章 芯片制造商行业发展趋势与投资建议

第一节 芯片制造商市场发展潜力分析

一、市场空间广阔

二、竞争格局变化

第二节 芯片制造商行业发展趋势分析

一、品牌格局趋势

二、行业技术趋势

第三节 芯片制造商行业发展战略研究

一、战略综合规划

二、技术开发战略

三、业务组合战略

四、区域战略规划

五、产业战略规划

六、营销品牌战略

七、竞争战略规划

第四节 对我国芯片制造商品牌的战略思考

一、企业品牌的重要性

二、芯片制造商实施品牌战略的意义

三、芯片制造商企业品牌的现状分析

四、我国芯片制造商企业的品牌战略

第十章 中国芯片制造商行业发展预测

第一节 2026-2031年中国芯片制造商行业产量预测

第二节 2026-2031年中国芯片制造商行业消费量预测

第三节 芯片行业发展趋势

第四节 对中国的启示

第十一章 芯片制造商行业投资前景与投资策略分析

第一节 行业swot模型分析

一、优势分析

二、劣势分析

三、机会分析

四、风险分析

第二节 芯片制造商行业投资价值分析

一、芯片制造商行业发展前景分析

二、芯片制造商行业盈利能力预测

三、投资机会分析

第三节 芯片制造商行业投资风险分析

一、政策风险

二、竞争风险

三、经营风险

四、其他风险

第四节 芯片制造商行业投资策略分析

一、重点投资品种分析

二、重点投资地区分析

第十二章 业内专家对中国芯片制造商行业总结及企业重点客户管理建议

第一节 芯片制造商行业企业问题总结

第二节 芯片制造商企业应对策略

一、把握国家投资的契机

二、竞争性战略联盟的实施

三、企业自身应对策略

第三节 芯片制造商市场的重点客户战略实施

一、实施重点客户战略的必要性

二、合理确立重点客户

三、对重点客户的营销策略

四、强化重点客户的管理

五、实施重点客户战略要重点解决的问题

第四节 芯片制造商项目投资建议

一、技术应用注意事项

二、项目投资注意事项

三、生产开发注意事项

四、销售注意事项

图表目录

图表：芯片制造产品结构

图表：2021-2026年信贷、社会融资、m2增速及预测(%)

图表：全球十大芯片公司2021-2026年财报营业收入

图表：2021-2026年中国led照明市场产值规模(单位：亿元)

图表：2021-2026年中国大陆主要晶圆厂分布情况(不含存储器产线)

图表：2021-2026年东北地区gdp总量

图表：2021-2026年华北地区gdp总量

图表：2021-2026年华东地区gdp总量

图表：2021-2026年华中地区gdp总量

图表：2021-2026年华南地区gdp总量

图表：2021-2026年西南地区gdp总量

图表：2021-2026年西北地区gdp总量

图表：2021-2026年集成电路封装测试产能(万块)

图表：4家纯晶圆代工厂每片晶圆营收均价变化

图表：2021-2026年中国芯片制造进口金额(单位：亿美元)

图表：2021-2026年中国芯片制造出口金额(单位：亿美元)

图表：2026-2031年中国芯片制造进口金额(单位：亿美元)

图表：2026-2031年中国芯片制造出口金额(单位：亿美元)

图表：2021-2026年全球半导体行业市占率按区域占比(单位：%)

图表：2021-2026年中国集成电路制造行业销售额(单位：亿元)

图表：2021-2026年中国集成电路产业销售额(单位：亿元)

图表：2026-2031年中国集成电路产业市场规模(单位：亿元)

图表：2021-2026年中国集成电路产量(单位：亿块)

图表：2021-2026年中国大陆前十大晶圆厂商

图表：2021-2026年全球成熟制程产能分布

图表：2021-2026年芯片制造行业总体营收(单位：亿元)

图表：中国芯片行业地区结构图

图表：主要晶圆代工企业在关键技术节点的量产时间对比

图表：三安光电使用材料及相关应用领域

图表：三安光电产业布局图

图表：2021-2026年三安光电资产负债表

图表：2021-2026年三安光电主营业务分行业、分地区、分产品情况

图表：2021-2026年三安光电芯片产销量

图表：2021-2026年中芯国际资产负债表

图表：2021-2026年中芯国际主营构成

图表：2021-2026年台积电资产负债表

图表：从细分市场看2021-2026年台积电营收分布

图表：从制程节点看2021-2026年台积电营收分布

图表：2021-2026年士兰微资产负债表

图表：2021-2026年士兰微主营收入构成

图表：2021-2026年士兰微主要产品产销量

图表：2021-2026年华虹资产负债表

图表：2021-2026年全球晶圆代工市场份额(单位：%)

图表：2026-2031年中国集成电路产量预测(单位：亿块)

图表：2026-2031年中国集成电路产业市场规模(单位：亿元)

把握投资 决策经营！

咨询订购 请拨打 400-886-7071 (免长途费) Email : kf@51baogao.cn

报告编号：216798

本文地址：<https://www.51baogao.cn/baogao/20210702/216798.shtml>

在线订购：[点击这里](#)